

**2024年3月期第2四半期(2023年4月～9月)
決算説明資料**

2023年11月9日

株式会社 KOKUSAI ELECTRIC

注意事項

本資料及び本資料にて提供される情報は企業情報等の提供のために作成されたものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他有価証券の勧誘を構成するものではありません。

■ 将来見通しについて

本資料に記述されている当社グループの事業計画、将来予測などは、当社グループが作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、将来の結果や業績を保証するものではありません。さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果は計画、予測と大きく異なる結果となる可能性があります。当社は、適用ある法令又は証券取引所の規則により要求される場合を除き、本資料に含まれるいかなる情報についても、今後生じる事象に基づき更新又は改訂する義務を負うものではありません。なお、当社グループの経営成績、財政状態、キャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があること認識している主なリスクは、有価証券報告書に記載しております。

■ 為替リスクについて

当社グループにおける海外売上収益は高い水準で推移しております。また、当社グループの外貨建ての資産および負債の評価は為替相場の変動により影響を受けますが、当社製品の輸出売上は、ほとんどが円建てで行われます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限り、利益への影響は軽微です。

■ 経営指標について

当社グループは、企業価値の向上に向けて経営成績の推移を把握するため、調整後営業利益、調整後当期(四半期)利益を重要な経営指標として位置付けております。

■ 会計基準について

当社は2021年3月期より国際会計基準(IFRS)に基づいて連結財務諸表を作成しております。

■ 数字の処理について

本資料に記載された金額(一部を除く)は、億円未満を四捨五入しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。



KOKUSAI ELECTRICグループについて

KOKUSAI ELECTRIC at a Glance

沿革

1949	国際電気(株)創業
2000	国際電気(株)／日立電子(株)／八木アンテナ(株)が合併 (株)日立国際電気を設立
2017	KKRが株主に参画
2018	会社分割を実施し、半導体製造装置専門に (株)KOKUSAI ELECTRICに社名変更
2023	東証プライム市場に上場

財務概要(23/3期)

売上収益 2,457 億円	売上総利益率 41.0%	調整後営業利益率 26.1%
売上収益CAGR (18/3期~23/3期) 12.9%	調整後ROE 28.6%	自己資本比率 43.5%

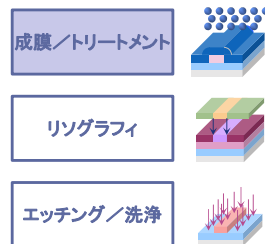
会社概要

会社名	株式会社KOKUSAI ELECTRIC	業種分類	電気機器
銘柄コード*	6525	決算期	3月
代表取締役	金井 史幸	会計基準	国際会計基準(IFRS)
従業員数 ¹	2,473人(連結)、1,129人(個別)	単元株式数	100株
直近の 受賞状況	 Intel EPIC Distinguished Supplier Award 2023	 TechInsights 10 BEST Suppliers 2023	 TSMC 2022 Excellent Performance Award

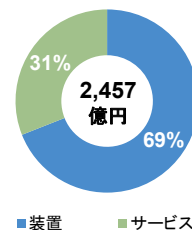
事業概要

当社は半導体製造の前工程における「成膜」プロセスに特化した装置専門メーカー

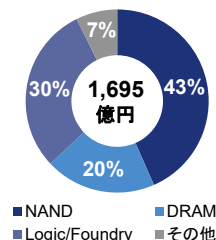
主要ビジネス領域
(半導体製造の前工程)



ビジネス別
売上収益(23/3期)



アプリケーション別
装置売上収益(23/3期)



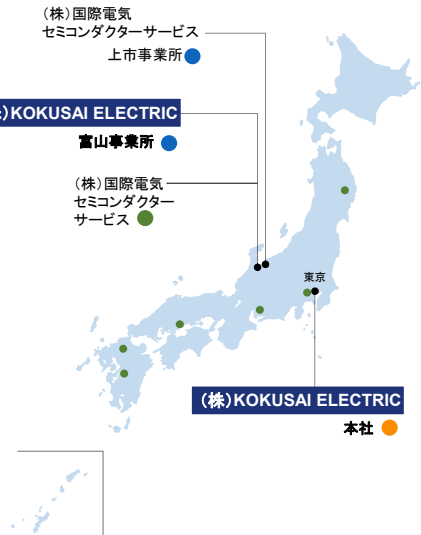
*1 2023年8月31日時点

事業拠点

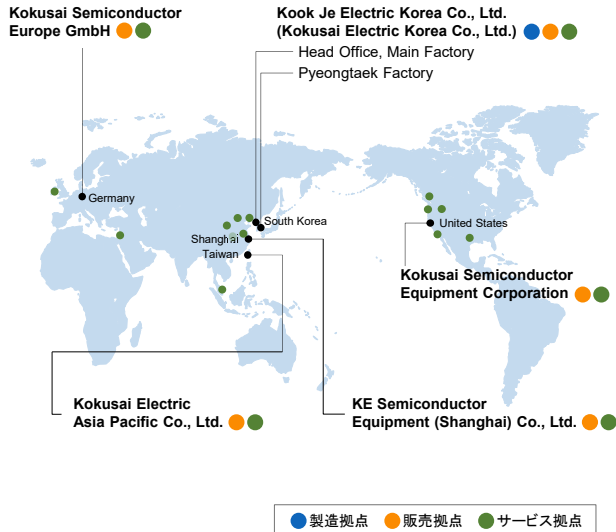
製造拠点は富山と韓国、事業拠点はアジア、中国、北米、欧州に展開。
24年秋の富山新工場の操業開始に伴い、製造・開発キャパシティは大きく拡大へ。

事業拠点

国内拠点



海外拠点



製造・開発キャパシティ^{*1,2}

製造キャパシティ^{*1}は
約2倍^{*3}に拡大の見通し



開発キャパシティ^{*2}は
約1.5倍^{*3}に拡大の見通し



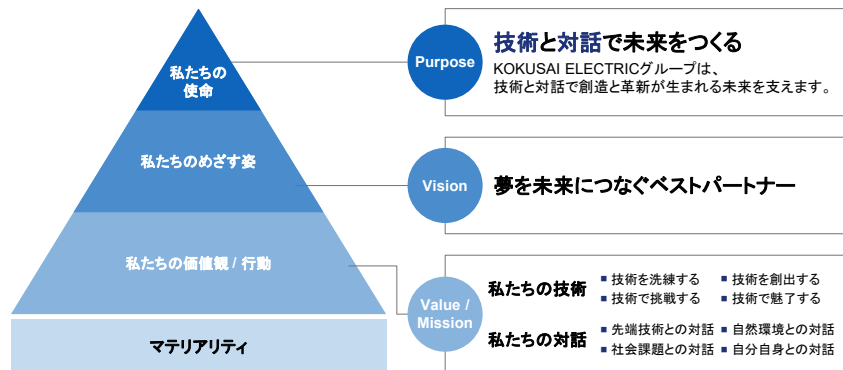
*1 グラフは最大生産台数/月 *2 グラフは評価装置台数 *3 21/3期との比較

中長期的な経営方針

“KOKUSAI ELECTRIC Way”（企業理念）に基づき、事業活動とESGの取り組みの両側面から経済価値と環境・社会価値を追求し、SDGsの達成に寄与するとともに、創造と革新が生まれる未来を支え続ける。

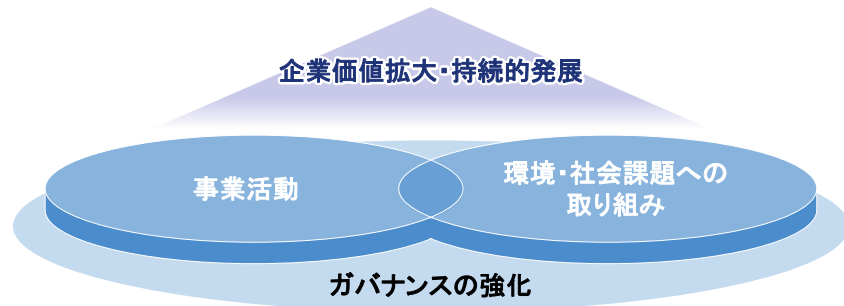
“KOKUSAI ELECTRIC Way”

KOKUSAI ELECTRIC Way



サステナビリティ経営

持続可能な社会の実現・SDGs達成への寄与



事業内容と主要製品

事業内容と23/3期売上収益構成比^{*1}

装置ビジネス (69%)

バッチ成膜装置

世界シェア No.1 (2022年)^{*2}

バッチALD

- 数十枚以上のウェーハを一括処理するバッチ成膜装置のうちALD技術に対応可能な装置。デバイスの複雑化に伴い、高難易度成膜と高生産性が求められるようになり、ニーズが拡大。
- ALD: Atomic Layer Depositionの略称。当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼ぶ。

バッチCVD

- CVD: Chemical Vapor Depositionの略称。ガスを同時に供給し、気相で化学反応を起こして成膜する手法。当社グループでは、LP-CVD: Low Pressure CVDに集中。

トリートメント装置

世界シェア No.2 (2022年)^{*3}

- 成膜後にプラズマや加熱により膜中の不純物を除去し、粒子を安定させることで、膜質を改善させることを目的とした装置。
- デバイスの複雑化に伴い、等方性と優れたステップカバレッジが求められ、ニーズが拡大。
- 低温環境における膜質改善のニーズが拡大。

サービスビジネス (31%)

- 当社グループが製造・販売する半導体製造装置のアフターサービス (部品販売、保守サービス、有償修理、装置の移設・改造、ウェーハサイズ200mm以下のレガシー装置販売など)。
- 部品販売・保守サービスでは、17/3期から23/3期にかけてインストールベースで前期比10%以上の着実な成長を達成。
- “Design for Service Business”のコンセプトでさらなる高付加価値サービスの提供をめざす。

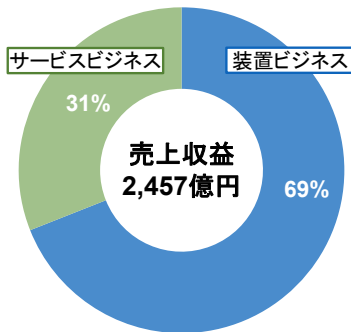
部品販売

保守サービス

有償修理

装置の移設・改造

レガシー装置販売



主力製品

ラージバッチ成膜装置「AdvancedAce[®]-300」



- 高品質な成膜性能と高生産性を備えた装置
- バッチALD技術、バッチCVD技術、酸化技術、拡散技術、アニール技術などに対応

ミニバッチ成膜装置「TSURUGI-C² 鋼[®]」



- 次世代対応に向けた成膜性能と高生産性を備えた装置
- 最新のバッチALD技術など薄膜形成プロセスに対応

枚葉トリートメント装置「MARORA[®]」



- 成膜後にプラズマや加熱により膜質を改善させることを目的とした装置
- 複雑な半導体形状に対して、高い生産性と品質でのトリートメントが可能

枚葉トリートメント装置「TANDUO[®]」



- 成膜後に加熱により膜質を改善させることを目的とした装置
- 低温でのアニールが可能

^{*1} 当社グループは、半導体製造装置事業の単一セグメントであるため、ビジネスごとに分類して記載 ^{*2} 出典: TechInsights Manufacturing Analysis Inc. (VLSI) “TI_ALD Tools_YEARLY” 2023 (April)

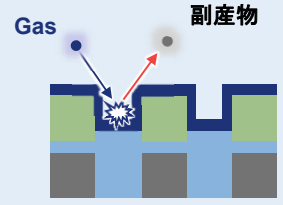
^{*3} Gartnerによる半導体製造装置 (前工程) セグメントにおける「RTP and Oxidation/Diffusion」を「トリートメント装置」と定義 (出典: “Gartner” Market Share Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2022, Bob Johnson et al., published April 17, 2023^{*)}

GARTNERは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved. Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに勧告するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性をきめ、一切の責任を負うものではありません。

バッチ成膜装置：デバイス複雑化に伴いバッチALD需要が拡大

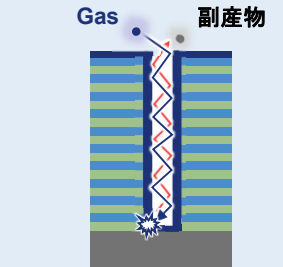
デバイス構造の複雑化に伴い、生産性の課題が顕在化、また難易度の高い成膜が不可欠に。
バッチALDは、高生産性と高難易度成膜を両立した最適なソリューション。

2D NANDにおける成膜



- 広いスペースでガスの反応が起こるため、ガスの移動距離が短い。
- 成膜に必要な表面積が小さく、またアスペクト比が低い構造。

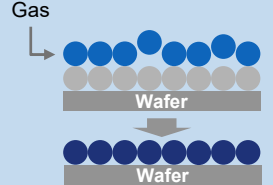
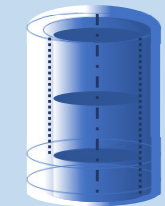
3D NANDにおける成膜



- 成膜に必要な表面積が拡大し、ガスの移動距離が長くなるため、成膜にかかる時間が増加。
- 表面積の拡大とアスペクト比の上昇が同時に発生し、難易度の高い成膜が不可欠。

高い生産性と難易度の高い高品質成膜の両立が可能なバッチALDの需要が拡大

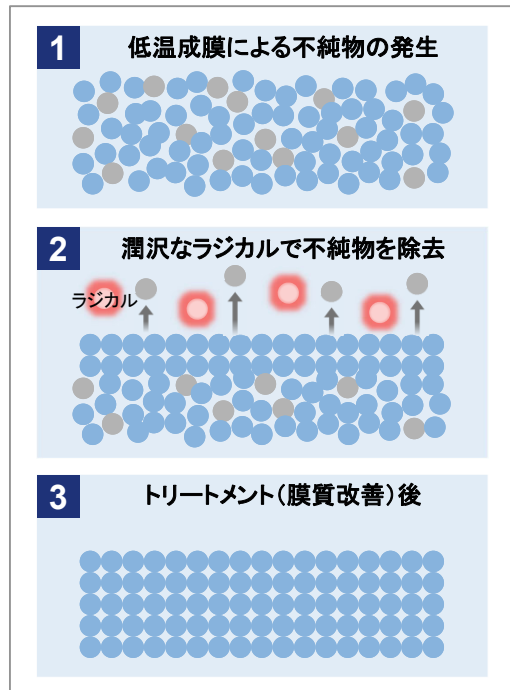
バッチ成膜技術 高生産性	×	ALD技術 高品質
数十枚以上のウェーハを一度に成膜		ウェーハ表面でガスが反応



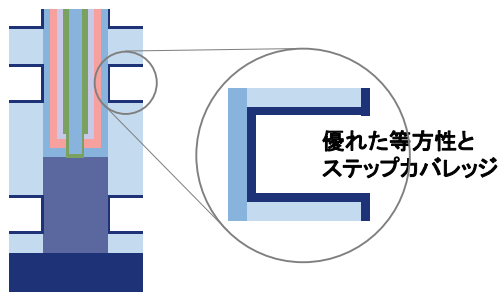
※イメージ

トリートメント装置: デバイス複雑化に伴いトリートメント需要も拡大

プラズマや加熱による幅広い温度レンジでのトリートメント(膜質改善)が可能。
高い生産性で優れた等方性、ステップカバレッジを実現するソリューション。

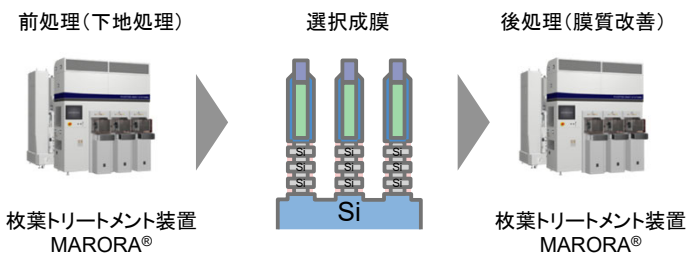


NAND・DRAMにおけるトリートメント(膜質改善)



- 成膜後に独自のプラズマ方式が生み出す潤沢なラジカルにより、コンフォーマルに膜質を改善。
- 複雑なデバイス構造に対して、高生産性と高品質でのトリートメント(膜質改善)を実現。
- NANDからDRAMへ適用範囲が拡大中。

Logicにおけるトリートメント(膜質改善)



- MARORA®と選択成膜を組み合わせることによりエッチングの工程を短縮し、膜へのダメージを回避。
- MARORA®による前処理(下地処理)と後処理(膜質改善)によって、理想的な選択成膜を実現。

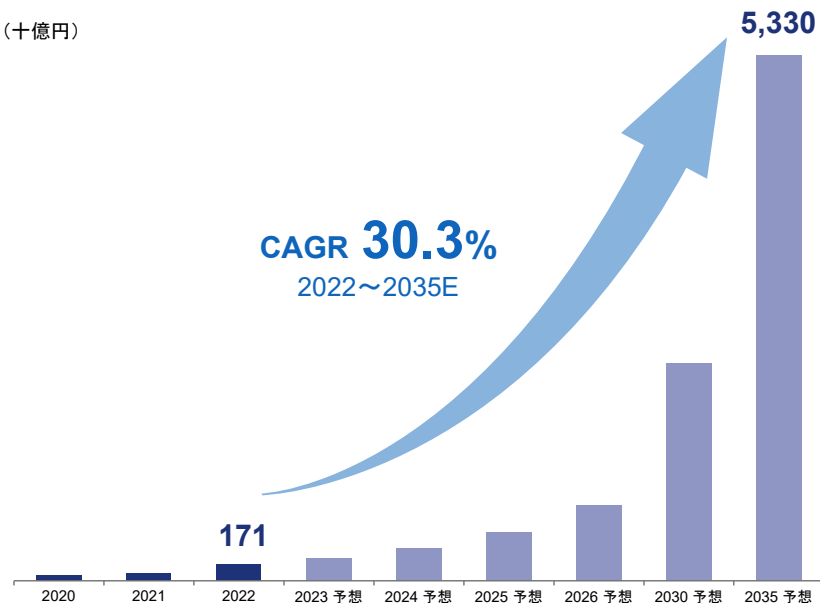
サービスビジネス: SiCパワーデバイスの急成長

ウェーハサイズ150~200mmのSiCパワーデバイス装置売上が伸長。

高温活性化アニールの新製品投入によりさらなる事業拡大をめざす。

SiCパワーデバイスの市場規模^{*1}

(十億円)

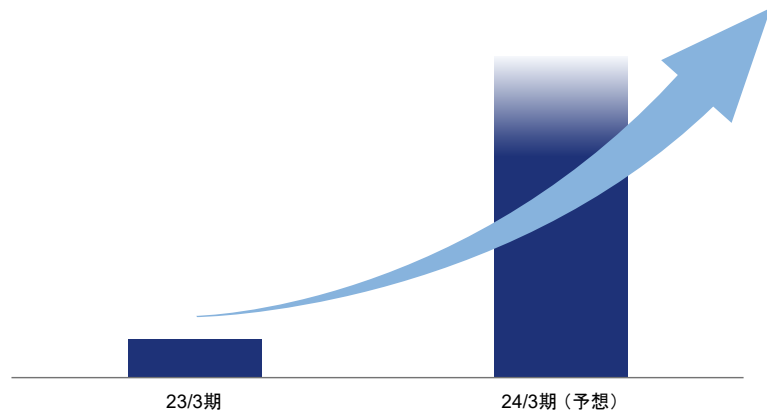


当社グループのSiCパワーデバイス売上収益

導入予定の新製品

High Temp Activation Anneal (~2,000C)

- 新たな加熱システムを採用



*1 出典: 富士経済“2023年版 次世代パワーデバイス&パワエレ関連機器市場の現状と将来展望”



2024年3月期第2四半期連結決算概要

2024年3月期第2四半期連結決算ハイライト

- 半導体デバイスの在庫調整が進んでおり、市況は底打ち。一部の半導体デバイスメーカーは引き続き投資抑制。
- 当社グループの2Q累計は前年同期比で減収減益ながら、1Q比で2Qは大きく改善。

2024年3月期業績予想

- 1Qは低調だったものの、2Qより回復に転じ、3・4Qで挽回する見通し。
成熟ノード向け投資が活発で当社売上収益を下支え。従来予想に変更なし。

中長期事業戦略

- 市場環境や顧客ニーズの変化に対応し、さらなる事業拡大を図るため、研究開発投資や設備投資を継続し、中長期的な成長をめざす。

連結業績サマリー

2Qは、1Qに引き続き半導体デバイスメーカーの投資抑制を受けて減収減益。1Q比では大きく改善。
売上総利益率は2Q累計で44.0%に改善。

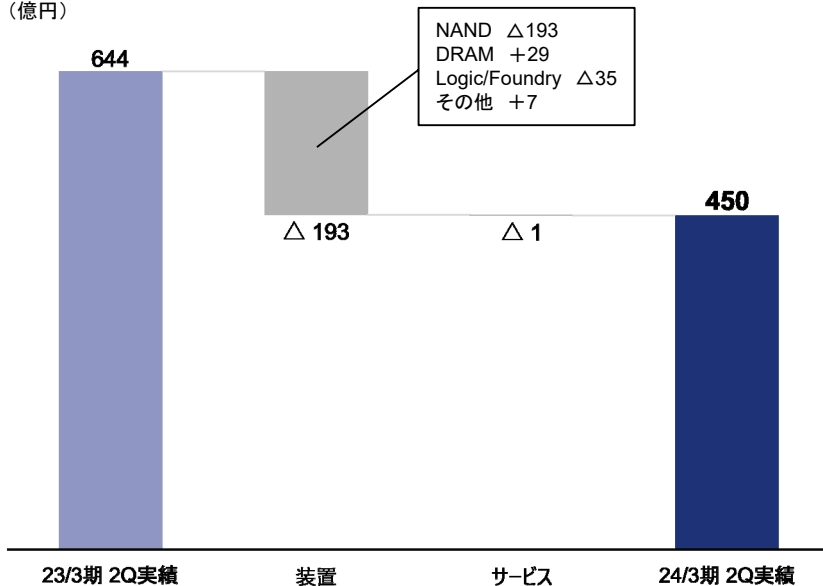
(億円)	23/3期			24/3期					
	1Q	2Q	2Q累計	1Q	2Q	前年同期比	前四半期比	2Q累計	前年同期比
売上収益	560	644	1,204	327	450	△ 30.1%	+37.6%	777	△ 35.5%
売上総利益	231	275	506	143	199	△ 27.6%	+39.3%	342	△ 32.5%
売上総利益率	41.2%	42.7%	42.0%	43.6%	44.2%	+1.5pts	+0.6pts	44.0%	+2.0pts
調整後営業利益	147	181	328	56	110	△ 39.0%	+96.6%	166	△ 49.2%
調整後営業利益率	26.2%	28.1%	27.2%	17.2%	24.5%	△ 3.6pts	+7.3pts	21.4%	△ 5.8pts
調整後四半期利益	108	125	233	38	73	△ 41.4%	+93.1%	111	△ 52.4%
調整後四半期利益率	19.3%	19.4%	19.3%	11.6%	16.2%	△ 3.2pts	+4.6pts	14.3%	△ 5.0pts
営業利益	130	164	294	40	94	△ 42.8%	+135.2%	134	△ 54.5%
営業利益率	23.2%	25.5%	24.4%	12.2%	20.9%	△ 4.6pts	+8.7pts	17.2%	△ 7.2pts
税引前四半期利益	129	164	293	37	91	△ 44.3%	+145.4%	129	△ 56.1%
税引前四半期利益率	23.0%	25.5%	24.4%	11.4%	20.3%	△ 5.2pts	+8.9pts	16.6%	△ 7.8pts
四半期利益	96	113	209	27	62	△ 45.5%	+131.9%	88	△ 57.8%
四半期利益率	17.1%	17.5%	17.4%	8.1%	13.7%	△ 3.8pts	+5.6pts	11.3%	△ 6.1pts
研究開発費	27	33	60	29	30	△ 8.2%	+3.1%	60	△ 0.4%
設備投資	7	29	36	51	21	△ 27.4%	△ 59.2%	71	+99.2%
減価償却費	25	26	51	26	27	+4.2%	+1.3%	53	+4.2%

2024年3月期第2四半期実績 増減要因

一部のデバイスメーカーの投資抑制により、装置の売上収益が減少し、前年同期比▲194億円。
装置売上減少に伴って売上総利益が減少し、調整後営業利益は前年同期比▲71億円。

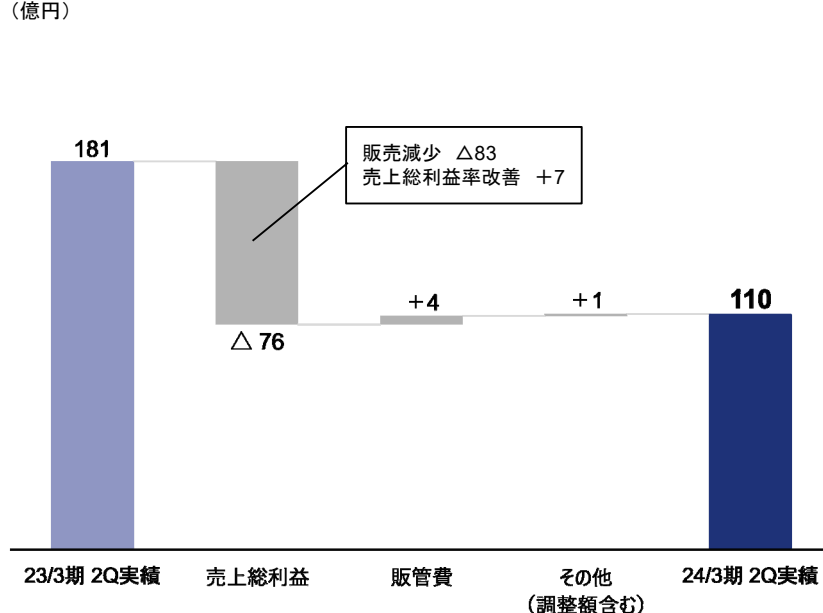
売上収益

(億円)



調整後営業利益

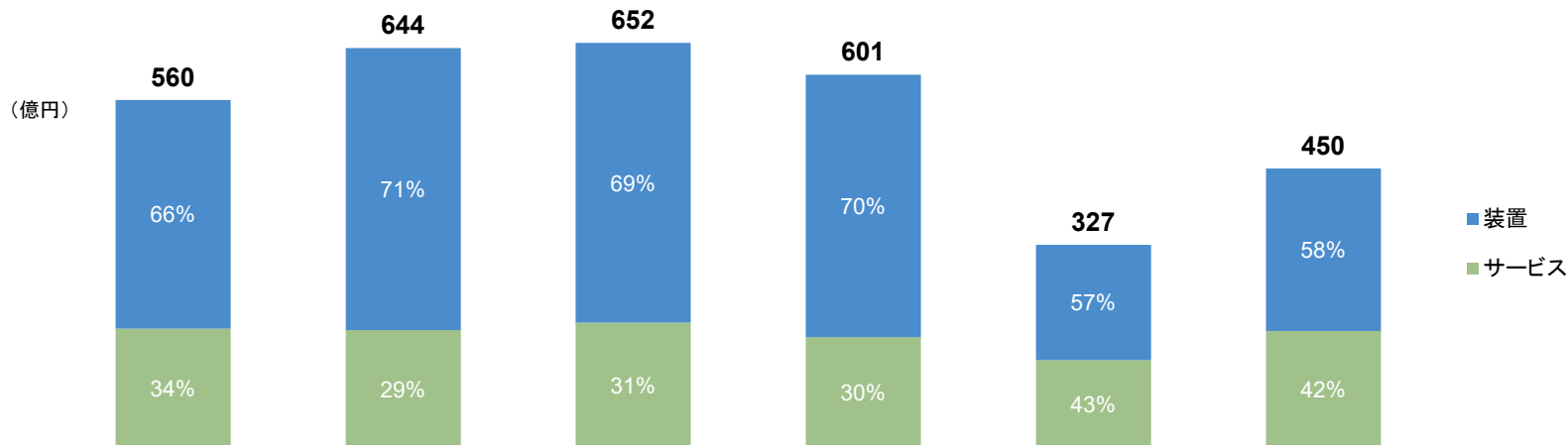
(億円)



売上収益 ビジネス別

23/3期のビジネス別売上構成は、装置が約7割、サービスが約3割。

24/3期は装置売上の減少も、サービスは好調持続で売上構成比が増加。

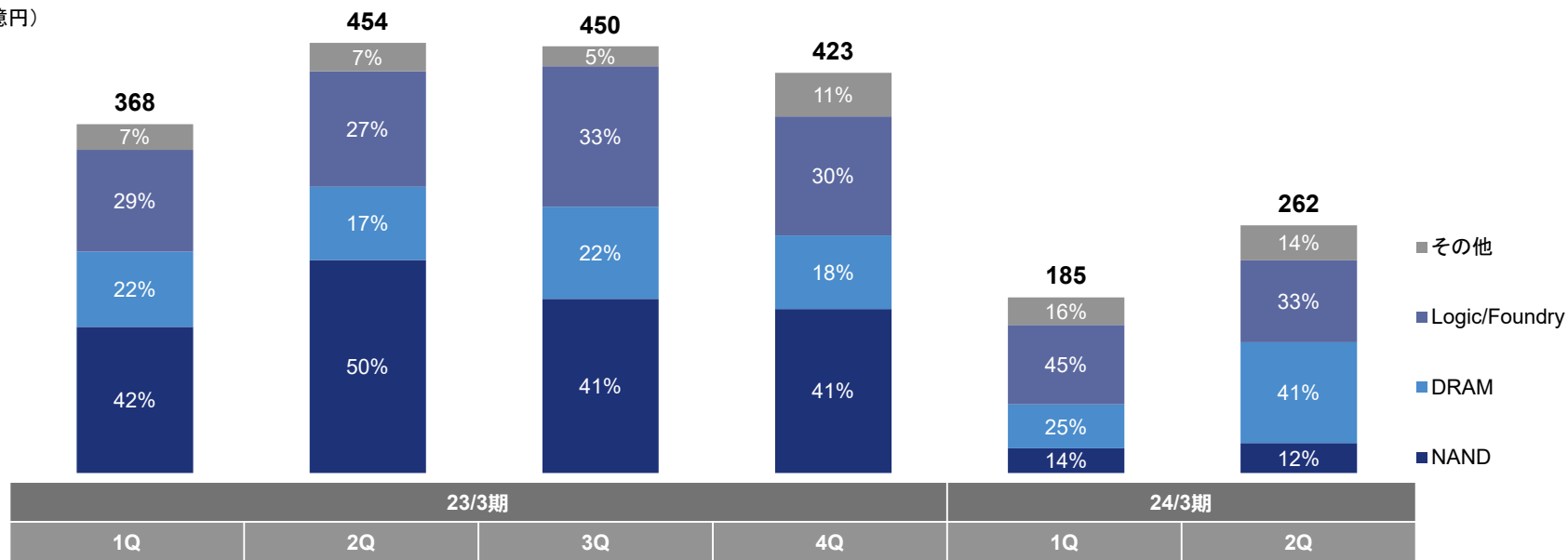


(億円)	23/3期				24/3期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
装置	368	454	450	423	185	262
サービス	192	190	202	178	142	188

売上収益 アプリケーション別(装置のみ)

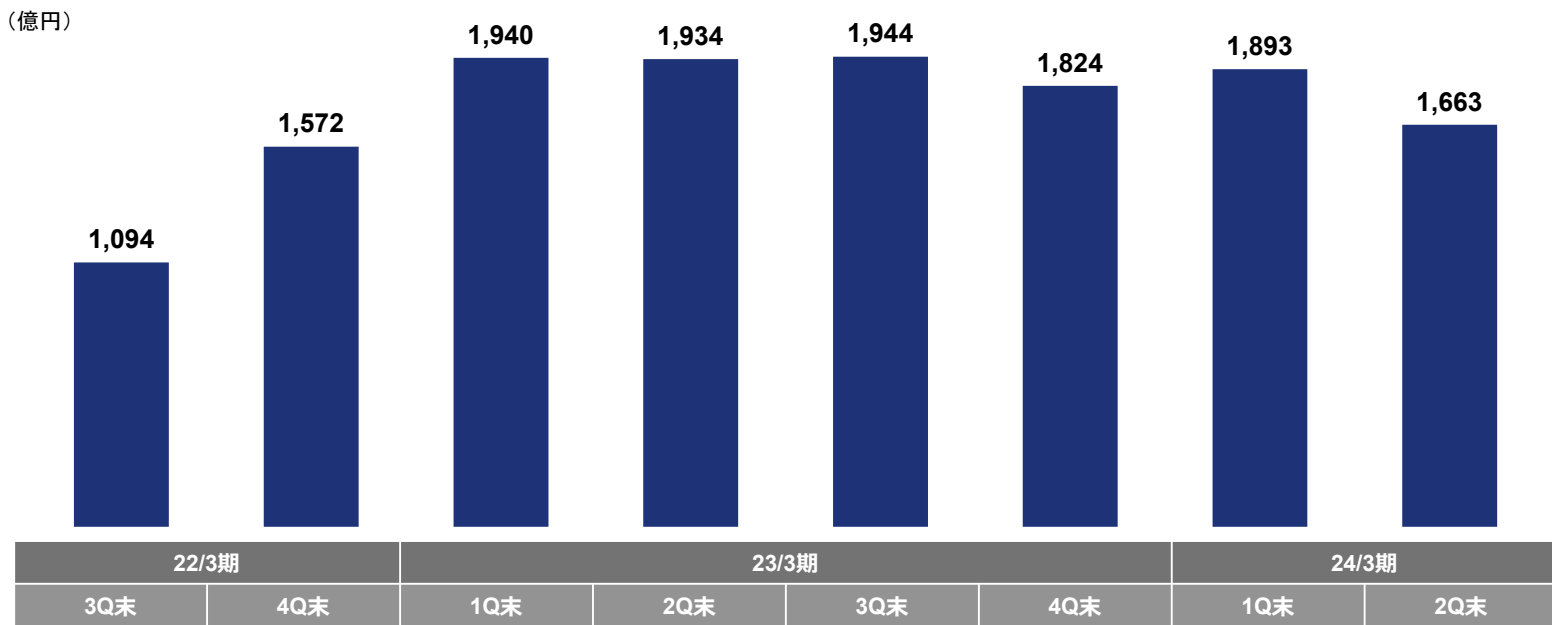
23/3期のアプリケーション別売上構成は、NANDが43%、DRAMが20%、Logic他が37%。
24/3期はNANDの減少により、Logic他の売上構成比が増加。

(億円)



受注残高の推移

長納期案件が売上に転換しはじめ、2Q末の受注残高は1,663億円と平常化へ。

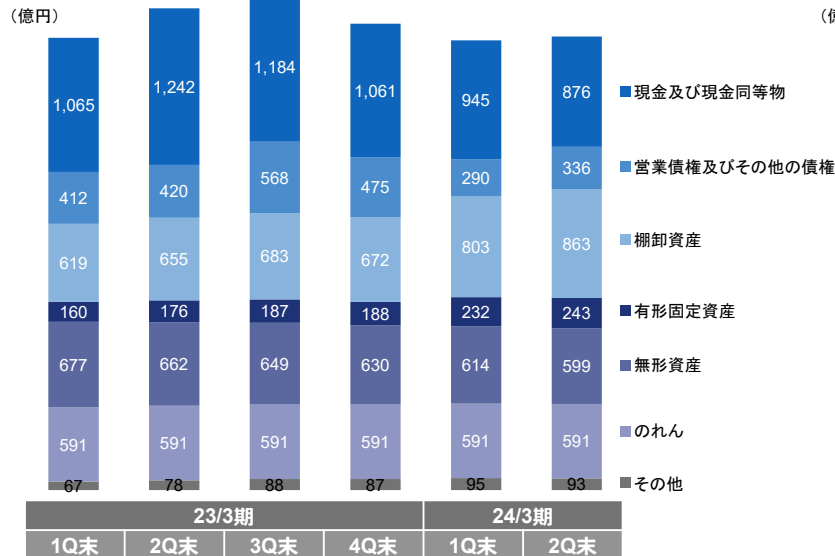


貸借対照表

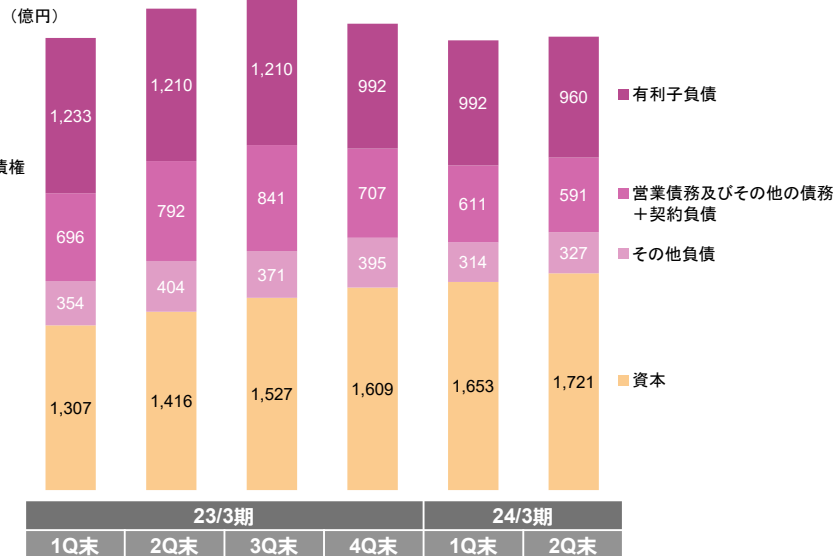
資産合計は、主に現金・現金同等物、営業債権等の減少により、前期末比で102億円減少。

負債合計は、主に営業債務等の減少により、前期末比で215億円減少。

資産



負債・資本

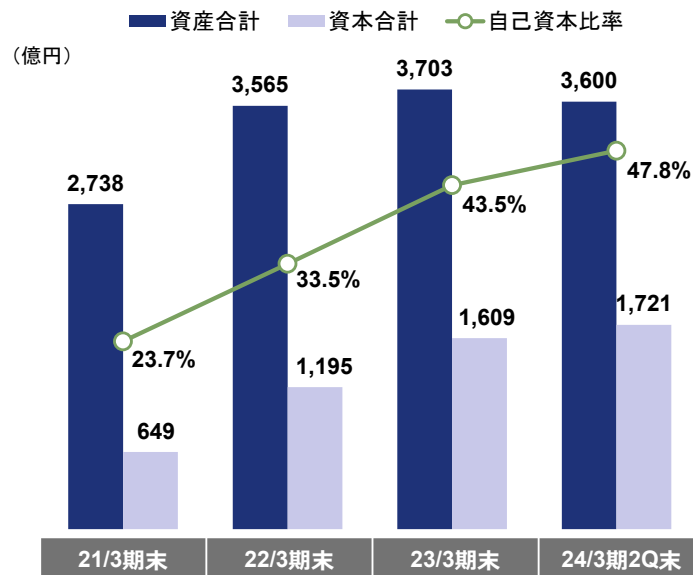


自己資本比率&現金及び現金同等物／有利子負債

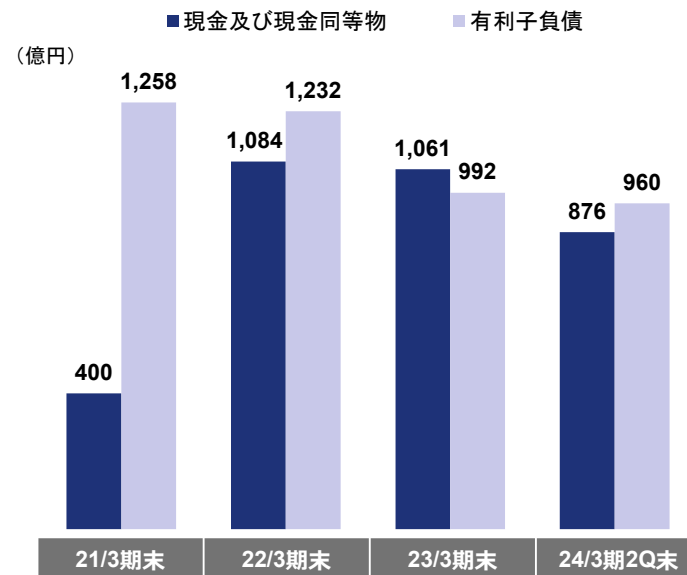
自己資本比率は、2Q末時点で47.8%に増加。

有利子負債は減少傾向にあり、23/3期末時点でネットキャッシュ化を達成。24/3期は営業CFが一時的に悪化しており、2Q末のネットデットは85億円。

資産合計／資本合計／自己資本比率



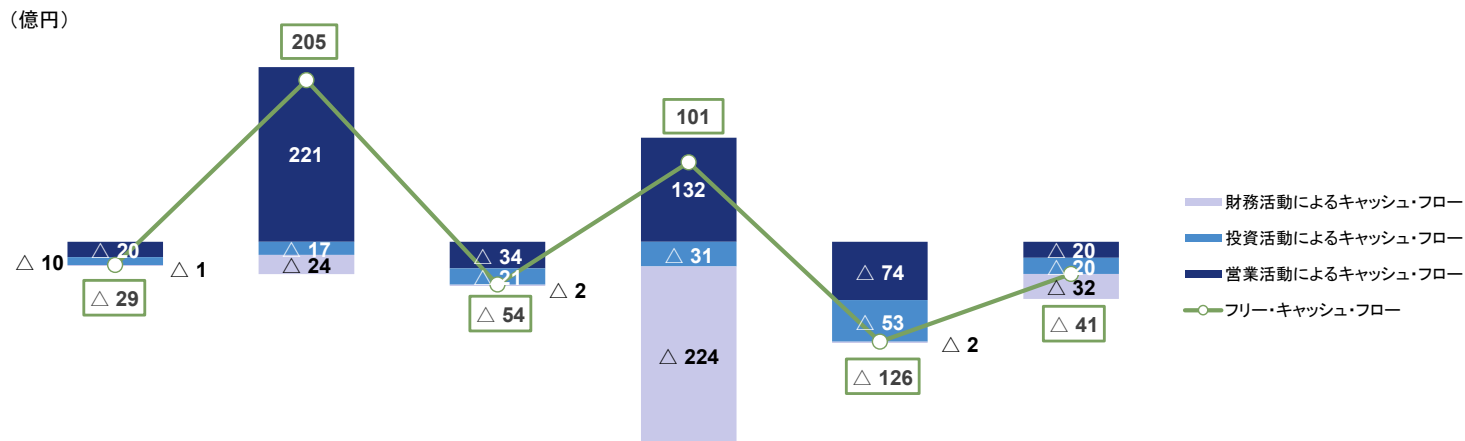
現金及び現金同等物／有利子負債



キャッシュ・フロー

24/3期は営業債務等、四半期利益の減少により営業CFが減少。

現金・現金同等物の四半期末残高は高水準を維持。



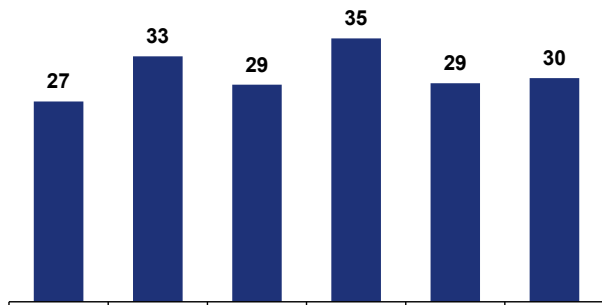
(億円)	23/3期				24/3期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
営業CF	△ 20	221	△ 34	132	△ 74	△ 20
投資CF	△ 10	△ 17	△ 21	△ 31	△ 53	△ 20
財務CF	△ 1	△ 24	△ 2	△ 224	△ 2	△ 32
FCF	△ 29	205	△ 54	101	△ 126	△ 41
現金及び現金同等物残高	1,065	1,242	1,184	1,061	945	876

研究開発費・設備投資

次世代の製品開発のための投資を実施しており、研究開発費は緩やかに増加。
設備投資は新工場建設やデモルーム拡張により、増加基調。

研究開発費

(億円)

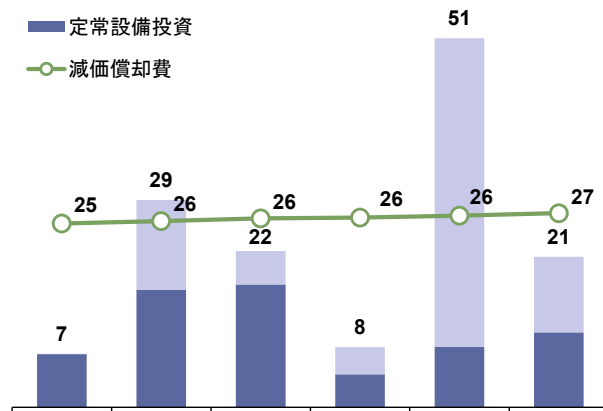


	23/3期				24/3期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
研究開発費	27	33	29	35	29	30
対売上収益比	4.8%	5.1%	4.5%	5.9%	9.0%	6.7%

設備投資

(億円)

- 大型設備投資(新工場建設、デモルーム拡張など)
- 定常設備投資
- 減価償却費



	23/3期				24/3期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
設備投資	7	29	22	8	51	21
対売上収益比	1.3%	4.4%	3.3%	1.4%	15.5%	4.6%



2024年3月期連結業績予想

2024年3月期第2四半期連結決算ハイライト

- 半導体デバイスの在庫調整が進んでおり、市況は底打ち。一部の半導体デバイスメーカーは引き続き投資抑制。
- 当社グループの2Q累計は前年同期比で減収減益ながら、1Q比で2Qは大きく改善。

2024年3月期業績予想

- 1Qは低調だったものの、2Qより回復に転じ、3・4Qで挽回する見通し。
成熟ノード向け投資が活発で当社売上収益を下支え。従来予想に変更なし。

中長期事業戦略

- 市場環境や顧客ニーズの変化に対応し、さらなる事業拡大を図るため、研究開発投資や設備投資を継続し、中長期的な成長をめざす。

2024年3月期業績予想

通期業績予想に変更なし。成熟ノード向けとDRAM向けの投資が下半期の業績を下支え。

(億円)	23/3期		24/3期		
	2Q累計	通期	2Q累計	通期	前期比
売上収益	1,204	2,457	777	1,800	△ 26.7%
売上総利益	506	1,008	342	737	△ 26.9%
売上総利益率	42.0%	41.0%	44.0%	40.9%	△ 0.1pts
調整後営業利益	328	643	166	363	△ 43.6%
調整後営業利益率	27.2%	26.1%	21.4%	20.1%	△ 6.0pts
調整後当期(四半期)利益	233	460	111	252	△ 45.3%
調整後四半期利益率	19.3%	18.7%	14.3%	14.0%	△ 4.7pts
営業利益	294	561	134	291	△ 48.1%
営業利益率	24.4%	22.8%	17.2%	16.2%	△ 6.6pts
税引前四半期利益	293	559	129	283	△ 49.4%
税引前四半期利益率	24.4%	22.7%	16.6%	15.7%	△ 7.0pts
当期(四半期)利益	209	403	88	202	△ 49.9%
四半期利益率	17.4%	16.4%	11.3%	11.2%	△ 5.2pts
1株当たり配当金(円)	-	-	-	11 ^{*1}	
配当性向	-	-	-	12.5%	

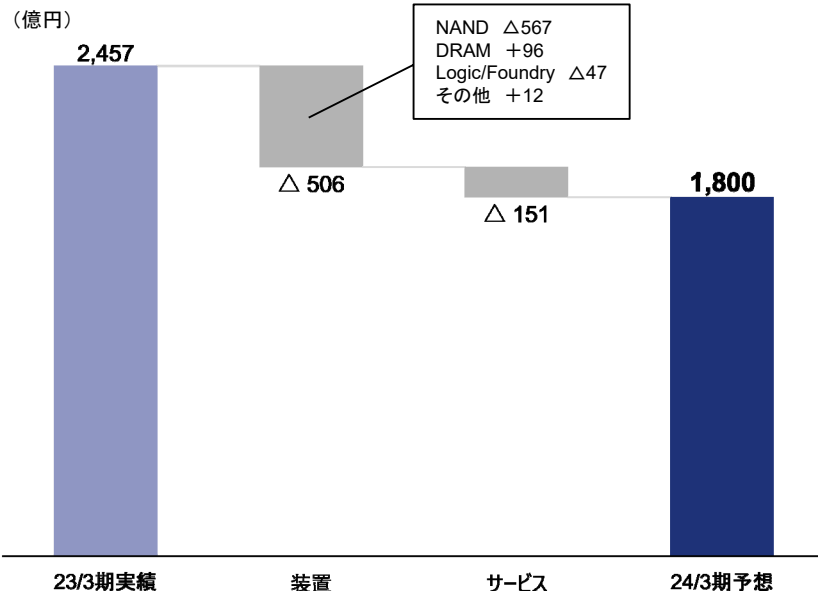
*1 24/3期予想の1株当たり配当金につきましては、上場時期が下半期であることを踏まえて半期分の金額とし、全額期末配当による支払いを予定しております。

2024年3月期業績予想 増減要因

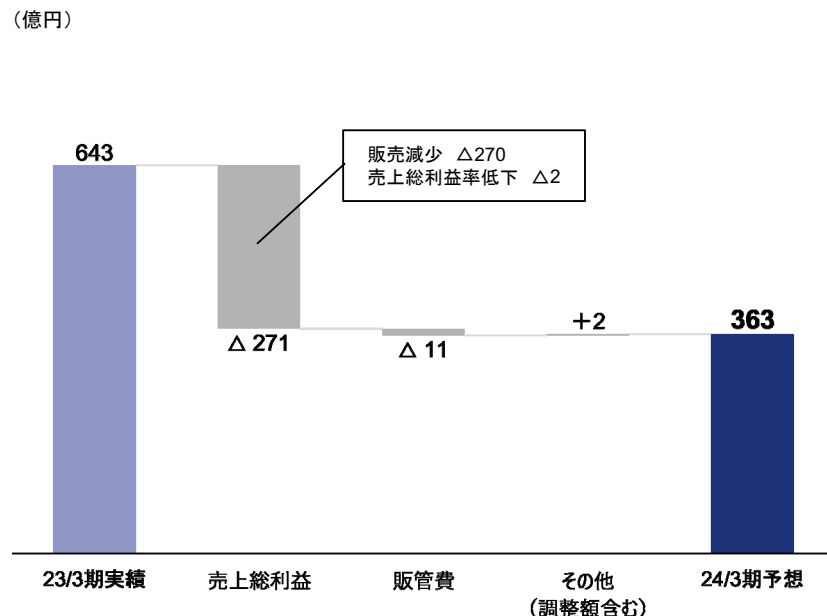
一部のデバイスメーカーの投資抑制の影響により、装置売上が減少する見通し。

装置を主とする売上収益の減少により、調整後営業利益も減少する見通し。

売上収益

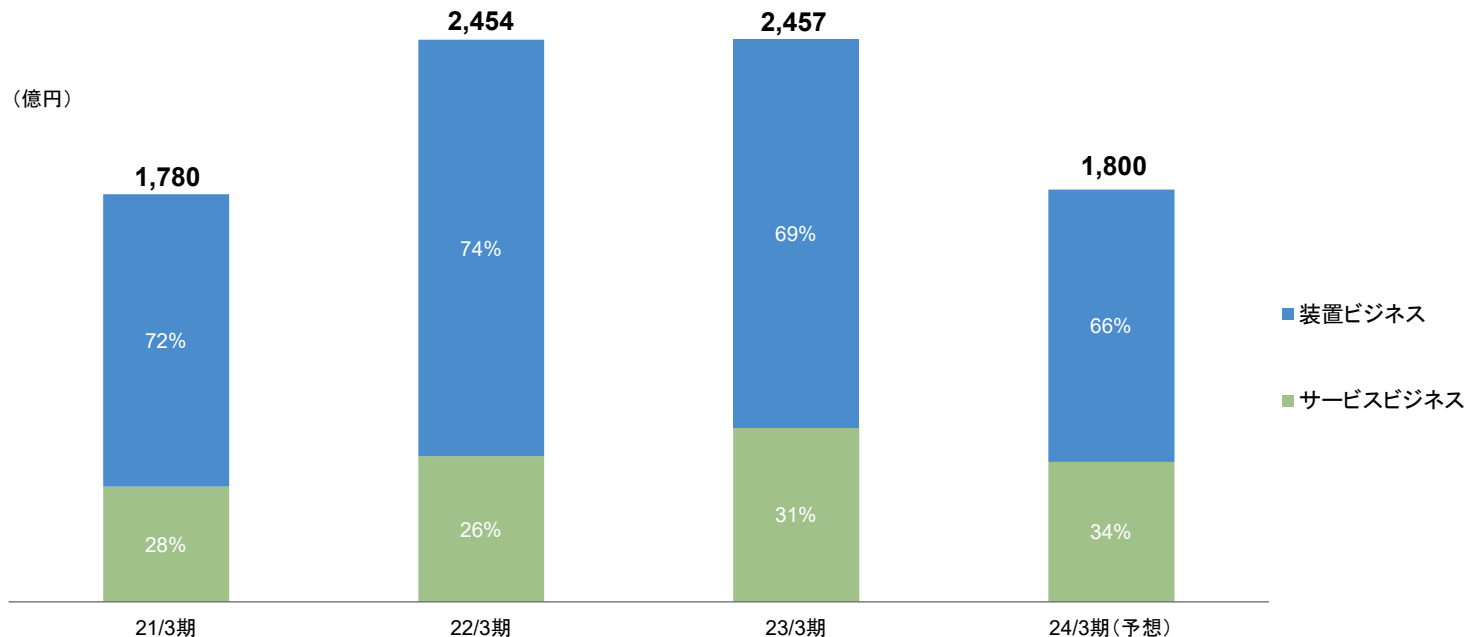


調整後営業利益



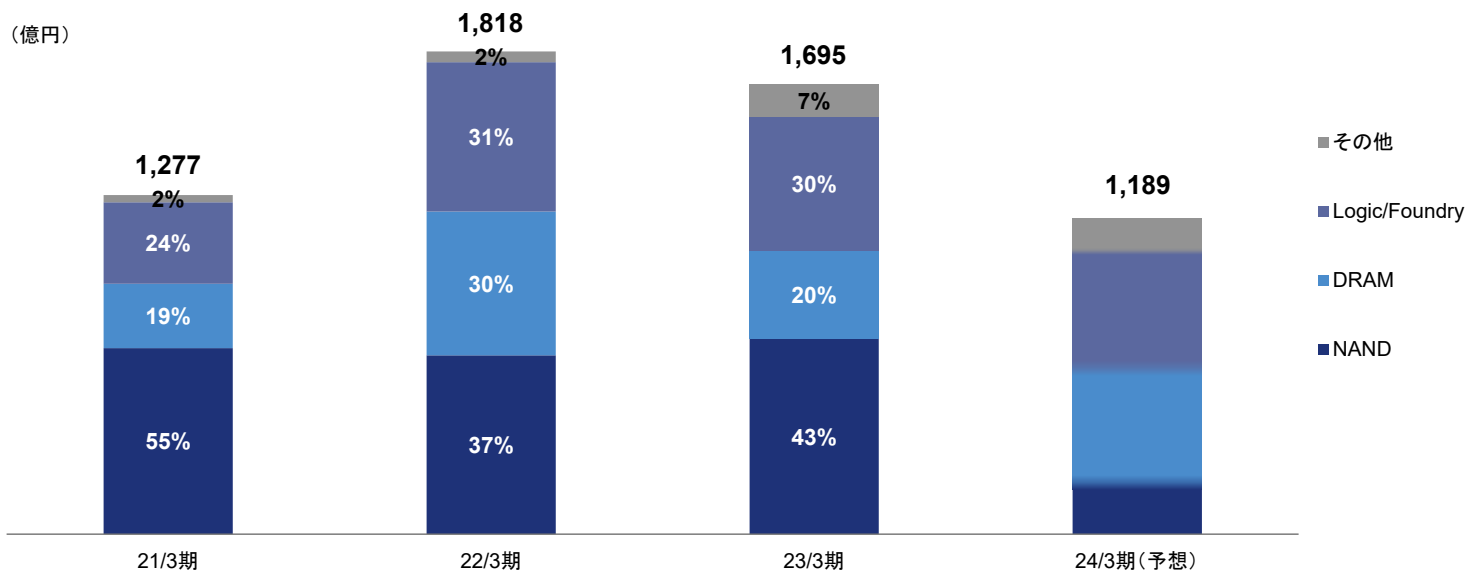
売上収益予想 ビジネス別

24/3期は装置売上の減少により、サービスビジネスの比率が一時的に拡大する見通し。



売上収益予想 アプリケーション別(装置のみ)

24/3期はメモリーへの投資抑制と成熟ノードへの投資活発化により、Logic/Foundry比率が上昇する見通し。





中長期的な事業戦略・事業目標

2024年3月期第2四半期連結決算ハイライト

- 半導体デバイスの在庫調整が進んでおり、市況は底打ち。一部の半導体デバイスメーカーは引き続き投資抑制。
- 当社グループの2Q累計は前年同期比で減収減益ながら、1Q比で2Qは大きく改善。

2024年3月期業績予想

- 1Qは低調だったものの、2Qより回復に転じ、3・4Qで挽回する見通し。
成熟ノード向け投資が活発で当社売上収益を下支え。従来予想に変更なし。

中長期事業戦略

- 市場環境や顧客ニーズの変化に対応し、さらなる事業拡大を図るため、研究開発投資や設備投資を継続し、中長期的な成長をめざす。

半導体デバイス・WFE市場は底打ちしたものと考えており、24年以降での回復を想定

■ 半導体デバイス市場

中長期的には、5G、AI、IoT、DXの拡がりによるデータセンターの拡充や環境負荷低減への投資(GX)等により、大きな成長が見込まれる。

■ WFE市場

半導体デバイスメーカー各社は先端品開発に対する投資を継続。

24年はほぼ横ばいを見込み、今後数年でUSD 110～120bn 程度の規模まで成長すると想定。

半導体デバイスの複雑化に伴い、付加価値の高い半導体製造装置の需要拡大を見込む。

24/3期及び25/3期の装置売上見通しについて

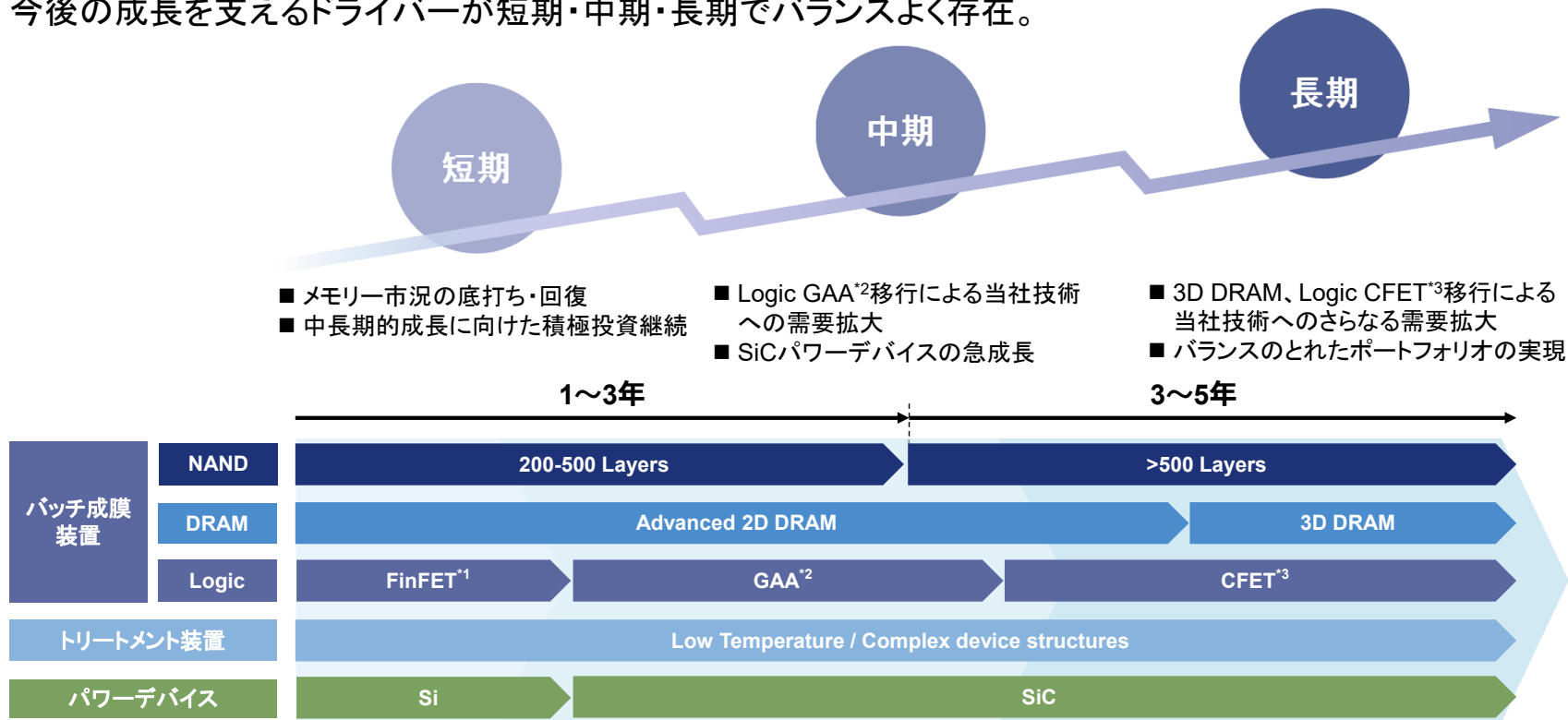
■ 24/3期の装置売上は23/3期比で大きく減少するものの、25/3期はWFEを上回る成長を想定。

■ アプリケーション別のトレンド

NAND	25/3期後半にかけて回復を見込む。
DRAM	最も安定した受注・売上を見込む。先端デバイスの量産回復が期待される。
Logic/Foundry	短期では中国向け成熟ノードが牽引し、その後はグローバルに先端向けが増え始めてバランスが改善すると見込む。
その他	SiCパワーデバイスの急成長が貢献すると見込む。

今後のビジネス展開

今後の成長を支えるドライバーが短期・中期・長期でバランスよく存在。

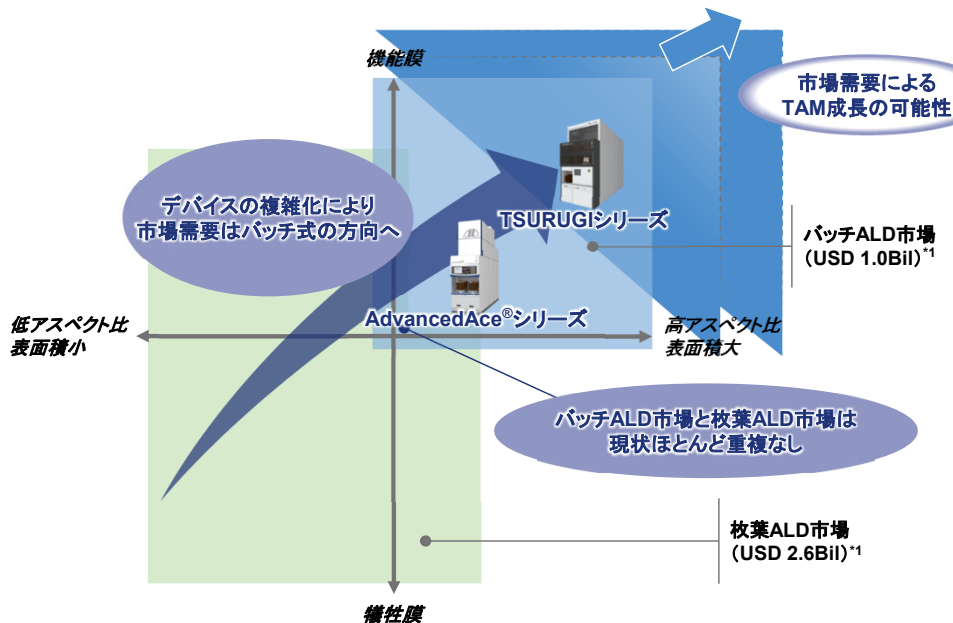


*1 Fin Field-Effect Transistorの略 *2 Gate All Aroundの略 *3 Complimentary Field Effect Transistorの略

バッチALD市場の見通し

デバイスの複雑化に伴い、バッチALD市場は拡大。枚葉ALD市場とすみ分けながら、NANDのみならずDRAM、LogicでもバッチALDに対するニーズは強まっていく見通し。

バッチALD市場／枚葉ALD市場のポジショニング



アプリケーション別のバッチALDの需要見通し

NAND

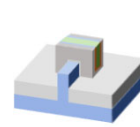
- 3D NANDのさらなる積層化により、バッチALDを必要とする工程は今後も増加。

DRAM

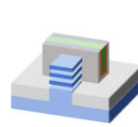
- デバイスの複雑化が進み、バッチ成膜が得意とする最先端領域の成膜需要が拡大。
- 3D DRAMへの移行により、バッチALDを必要とする工程はさらに拡大。

Logic/Foundry

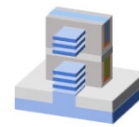
- FinFetからGAA、CFETへの移行により、デバイス構造の複雑化、三次元化が進み、バッチALDを必要とする工程は増加。



FinFET



GAA



CFET

*1 公開情報・当社売上収益に基づき当社推定

中長期事業目標

中長期的な成長を見据えて研究開発投資の拡充、製造体制・開発体制の増強をはかり
売上成長・利益拡大をめざす。

(億円)	22/3期 実績	23/3期 実績	中長期事業目標
売上収益	2,454	2,457	3,000~3,300
装置ビジネス売上比率	74%	69%	70~75%
サービスビジネス売上比率	26%	31%	25~30%
売上総利益	43.6%	41.0%	43.0%以上
研究開発費(対売上収益比率)	4.0%	5.1%	6%程度
調整後営業利益率	32.4%	26.1%	28~30%
(参考)前提としたWFE市場規模	\$90 Bn(2021年)	\$100 Bn(2022年)	\$110~120 Bn

株主還元方針

成長投資を最優先に、高い水準での株主還元の実施をめざす。

連結配当性向：20～30%程度を目安に配当を実施予定

- 将来の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様に対する安定的・継続的かつ積極的な利益還元を実施することを、経営の重要課題と位置づけ。

ネットキャッシュがプラスに転換した後は、自己株式取得を含めたさらなる株主還元をめざす

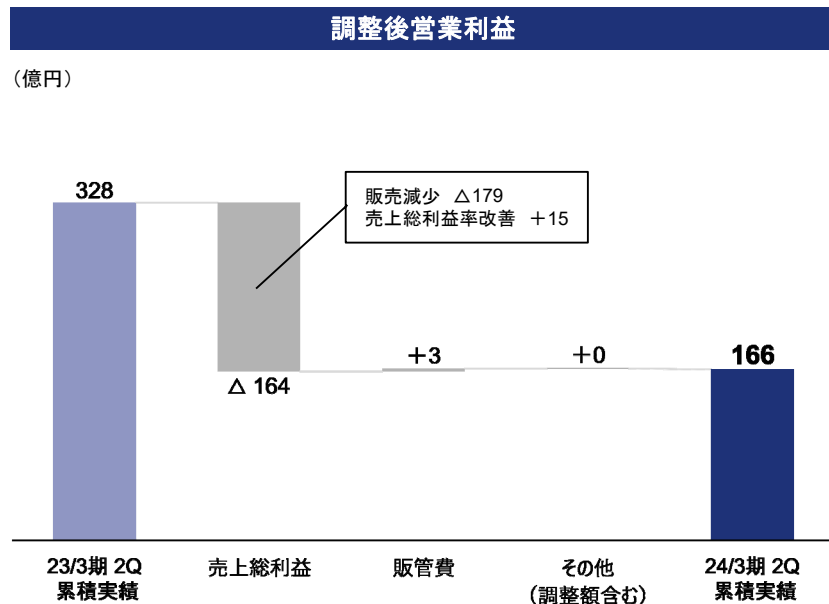
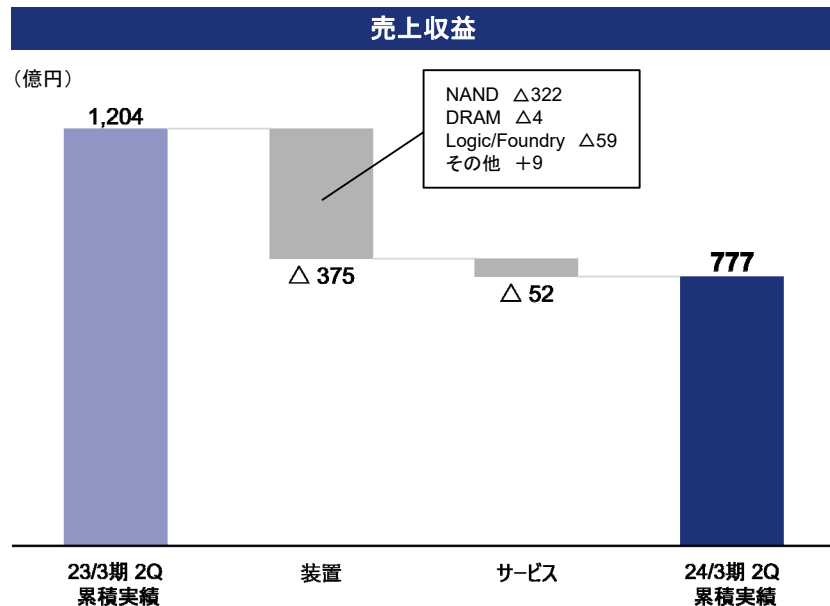
- ネットキャッシュがプラスに転換した後は、さらなる株主利益と資本効率の向上に向け、有利子負債分割償還後フリー・キャッシュ・フローの70%程度に相当する金額を配当及び自己株式取得に充当することをめざす。



Appendix

2024年3月期第2四半期(累計)実績 増減要因

一部のデバイスメーカーの投資抑制により、売上収益は装置、サービスとも減少し、前年同期比▲427億円。売上収益減少に伴い売上総利益が減少し、調整後営業利益は前年同期比▲162億円。



損益計算書及び研究開発費、設備投資、減価償却費

(百万円)	23/3期					24/3期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q
売上収益	56,035	64,385	65,216	60,085	245,721	32,710	44,995
売上総利益	23,090	27,489	26,359	23,867	100,805	14,275	19,890
売上総利益率	41.2%	42.7%	40.4%	39.7%	41.0%	43.6%	44.2%
調整後営業利益	14,700	18,102	17,154	14,295	64,251	5,614	11,035
調整後営業利益率	26.2%	28.1%	26.3%	23.8%	26.4%	17.2%	24.5%
調整後四半期利益	10,796	12,473	12,193	10,523	45,985	3,782	7,304
調整後四半期利益率	19.3%	19.4%	18.7%	17.5%	18.7%	11.6%	16.2%
営業利益	12,984	16,407	15,527	11,146	56,064	3,990	9,383
営業利益率	23.2%	25.5%	23.8%	18.6%	22.8%	12.2%	20.9%
税引前四半期利益	12,901	16,429	15,667	10,898	55,895	3,727	9,145
税引前四半期利益率	23.0%	25.5%	24.0%	18.1%	22.7%	11.4%	20.3%
四半期利益	9,605	11,297	11,064	8,339	40,305	2,655	6,158
四半期利益率	17.1%	17.5%	17.0%	13.9%	16.4%	8.1%	13.7%
研究開発費	2,688	3,293	2,912	3,532	12,425	2,932	3,023
設備投資	736	2,853	2,151	828	6,568	5,077	2,071
減価償却費	2,529	2,563	2,600	2,612	10,304	2,637	2,671

調整後利益等の計算における調整項目

(百万円)	23/3期					24/3期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q
営業利益	12,984	16,407	15,527	11,146	56,064	3,990	9,383
－その他の収益	△30	△30	△191	△19	△270	△30	△110
＋その他の費用	23	88	41	1,410	1,562	45	33
(調整額)							
＋企業結合により識別した無形資産等の償却	1,592	1,593	1,592	1,592	6,369	1,592	1,592
＋スタンドアロン関連費用	105	16	156	76	353	1	10
＋株式報酬費用(業績連動型株式報酬制度に係るものを除く)	26	28	29	90	173	16	127
調整額 計	1,723	1,637	1,777	1,758	6,895	1,609	1,729
調整後営業利益	14,700	18,102	17,154	14,295	64,251	5,614	11,035
当期(四半期)利益	9,605	11,297	11,064	8,339	40,305	2,655	6,158
－その他の収益	△30	△30	△191	△19	△270	△30	△110
＋その他の費用	23	88	41	1,410	1,562	45	33
(調整額)							
＋企業結合により識別した無形資産等の償却	1,592	1,593	1,592	1,592	6,369	1,592	1,592
＋スタンドアロン関連費用	105	16	156	76	353	1	10
＋株式報酬費用(業績連動型株式報酬制度に係るものを除く)	26	28	29	90	173	16	127
－調整項目に対する税金調整額	△525	△519	△498	△965	△2,507	△497	△506
調整後当期(四半期)利益	10,796	12,473	12,193	10,523	45,985	3,782	7,304

貸借対照表及び主要財務指標

(百万円)			23/3期 4Q末	24/3期 1Q末	24/3期 2Q末
資産	流動資産	現金及び現金同等物	106,053	94,493	87,550
		営業債権及びその他の債権	47,477	28,967	33,588
		棚卸資産	67,197	80,273	86,283
		その他	1,917	1,809	1,213
		流動資産合計	222,644	205,542	208,634
	非流動資産	有形固定資産	18,775	23,227	24,325
		のれん	59,065	59,065	59,065
		無形資産	62,968	61,420	59,941
		その他	6,811	7,651	8,074
		非流動資産合計	147,619	151,363	151,405
資産合計			370,263	356,905	360,039

(百万円)			23/3期 4Q末	24/3期 1Q末	24/3期 2Q末	
負債	流動負債	借入金	6,000	6,000	6,750	
		営業債務及びその他の債務	41,790	28,982	29,645	
		契約負債	28,918	32,068	29,354	
		その他流動負債	21,469	13,875	15,009	
		流動負債合計	98,177	80,925	80,758	
	非流動負債	借入金	91,500	91,500	87,750	
		その他非流動負債	19,705	19,151	19,395	
		非流動負債合計	111,205	110,651	107,145	
	負債合計			209,382	191,576	187,903
	資本	資本合計	160,881	165,329	172,136	
負債及び資本合計			370,263	356,905	360,039	

	23/3期 4Q末	24/3期 1Q末	24/3期 2Q末
自己資本比率	43.5%	46.3%	47.8%
D/Eレシオ	0.6	0.6	0.6
ネット・キャッシュ(百万円)	6,847	△ 4,659	△ 8,491

キャッシュ・フロー

(百万円)	23/3期					24/3期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,950	22,120	△ 3,351	13,174	29,993	△ 7,365	△ 2,030
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 982	△ 1,657	△ 2,069	△ 3,117	△ 7,825	△ 5,278	△ 2,037
フリー・キャッシュ・フロー	△ 2,932	20,463	△ 5,420	10,057	22,168	△ 12,643	△ 4,067
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 120	△ 2,425	△ 163	△ 22,405	△ 25,113	△ 167	△ 3,171
現金及び現金同等物の四半期期首残高	108,399	106,464	124,198	118,403	-	106,053	94,493
現金及び現金同等物の四半期末残高	106,464	124,198	118,403	106,053	-	94,493	87,550

サステナビリティ経営 マテリアリティ

5つのマテリアリティを特定し、課題解決に向けた活動を加速。サステナビリティ経営を推進していく上で、特に重要視している課題を主観的・客観的な視点から再認識し、課題ごとにKPIを定め活動中。

マテリアリティ／重点テーマ	マテリアリティに基づく活動アイテム
■ 創造と革新による社会への貢献	
新技術・新製品の創出	先行要素開発・外部機関との共同開発推進
お客様満足度の向上	VOC ^{*1} に対応した製品・技術、サービスの提供
経済パフォーマンスの向上	業績・投資等の向上、投資効果の確認
■ 持続可能な社会の創造・地球環境の保全	
環境負荷の低減	温室効果ガスの排出削減
	エネルギー管理の徹底
	廃棄物・有害物質管理の徹底
	水・排水管理の徹底
技術・製品を通じた環境への貢献	環境配慮製品の開発
持続可能な調達推進	サプライチェーン・マネジメントの強化

*1 Voice of Customerの略

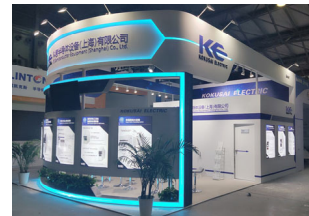
*2 Super Clean Roomの略

マテリアリティ／重点テーマ	マテリアリティに基づく活動アイテム
■ イノベーション創出の源泉となる人財マネジメント	
多様な人財の尊重	ダイバーシティ&インクルージョンの推進
自ら学び、考え、実行する人財の開発	グローバル人財の育成、優秀人財の確保
健康と安全の維持・向上	労働安全衛生マネジメントの強化
■ サステナビリティ経営の実現に向けたガバナンス体制の強化	
ガバナンスの強化	コーポレート・ガバナンスの強化
	コンプライアンスの徹底
重大ビジネスリスク・マネジメントの徹底	SCR ^{*2} ／CRリスク対策・BCPの強化
	情報セキュリティリスク対策・BCPの強化
経営の透明性確保	適時・適切な社内外への情報開示
■ 人権の尊重・配慮	
人権の尊重	人権に関する社内理解の促進・啓発

2024年3月期第2四半期(累計)の主な活動報告

事業活動

- TechInsightsの顧客満足度調査で「10 BEST Suppliers」を26年連続受賞、また製品の種類別に優れた半導体製造装置サプライヤーを表彰する「THE BEST Suppliers」受賞。(23/5)
- インテルコーポレーションより2023 EPIC Distinguished Supplier Awardを受賞。(23/6)
- 各地域で開催された半導体業界の展示会「SEMICON® China 2023(23/6)」「SEMICON® West 2023(23/7)」および「SEMICON® Taiwan 2023(23/9)」に出展。
- 当社が参画する「集積Green-niX研究・人材育成拠点」が 文部科学省「次世代X-nics半導体創生拠点形成事業」に採択。(23/7)



2024年3月期第2四半期(累計)の主な活動報告

ESGの取り組み

- 女性の活躍推進に積極的に取り組む企業の行動原則を示した、女性のエンパワーメント原則(WEPEs)に署名。(23/4)
- 地域貢献活動の一環として保育所施設で青空環境教室を実施。(23/6)
- 当社グループにおけるコンプライアンス強化を目的として、「コンプライアンス通報制度」を拡充。(23/6)
- 子育てサポート企業として厚生労働大臣が認定する「くるみん認定」を取得。(23/7)
- 富山事業所が拠点を構える富山市八尾地区で開催される行事「おわら風の盆」に協賛。(23/9)



